

吉安满坤科技股份有限公司

2024年5月10日投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年5月10日（星期五）15:00-16:00
地点	“价值在线”（www.ir-online.cn）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：洪俊城先生 副董事长：洪丽旋女士 财务总监：何惠红女士 董事会秘书：耿久艳女士 独立董事：张清伟先生 保荐代表人：马睿先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.你好！现在市场上贵金属涨价对公司的影响是怎样的？</p> <p>答:投资者您好，公司的贵金属材料主要包括：铜箔，铜球，金盐，锡球，锡条。贵金属的涨价会对公司的生产成本带来一定影响，进而影响毛利，公司针对不同的客户采取差异化方案积极应对成本涨价对毛利的影响，针对汽车客户，公司将会积极沟通降低年降比例，针对消费电子客户，公司将主动涨价进而将成本压力转移下游客户。公司将持续关注国际市场以及上游原材料价格变化，并与供应商及客户保持积极沟通。同时公司将通过技术工艺创新、产品结构优化、精细化生产管理、和客户沟通产品提价等举措，将原材料价格上涨的压力予以转移或消化。</p>

2.公司年报提到 HDI，HDI 在公司产品规划是怎样的？

答:投资者您好，公司一直在储备 HDI 技术，HDI 起步产品主要为 LED 以及 Micro Led 等产品，目前可以满足 10 层 2 阶产品的批量生产。同时也在为工控以及车载摄像模组、ADAS、域控方面的产品做技术开发。谢谢

3.请问总经理，公司目前稼动率如何？

答:投资者您好，公司目前稼动率比第一季度有所提升。

4.请董事长介绍下公司 2024 年业绩预计怎样？

答:投资者您好，公司 2023 年实现营收 12.17 亿元，达成 23 年公司股权激励设置的营收增长基准目标。按照公司股权激励设置的指标，2024 年营收增长基准值 45%，即 15.11 亿元，目标值 65%，即 17.19 亿元。围绕此目标，公司从 4 个方面积极努力：（1）市场开发计划 （2）产品研发计划 （3）募投项目试产计划 （4）长期高效管理计划。2024 年具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告。

5.公司预计在泰国投资建厂，海外销售情况是怎样的？

答:投资者您好，2023 年公司境外销售占比从 14.06%增加到 18.67%，2024 年以来海外客户订单情况保持稳定，同时公司重点开发其他符合战略布局的国外优质客户群体。

6.请问公司在汽车电子领域的战略规划是什么？

答:投资者您好，汽车电子领域一直是公司战略布局的重点领域。经过多年在汽车电子领域的沉淀，公司已经取得多个国际知名汽车电子零部件供应商和终端车厂的认证，并已与主要客户确定上百个定点项目。未来，公司将稳步提升汽车电子 PCB 产能，并逐步加大对汽车电子产品的研发投入。在智能座舱产品上，公司聚焦在精细线，高多层，阻抗控制等技术；在热管理应用产品上，公司重点关注铝基，铜基，埋嵌铜，HSP 等技术；在新能源三电系统产品上，公司在厚铜，平面变压，高压 CAF 技术上已有一定积累；在 ADAS 产品上，公司在精细线，高多层，微小孔，阻抗控制，盲埋孔等技术上已取得一定突破。

7.领导好，公司 2023 年的营业收入较上年增长了 16.81%，请问这一增长的主要驱动因素是什么？

答:投资者您好，公司实现营业收入人民币 12.17 亿元，较上年同期增长 16.81%。主要增长驱动因素得益于以下几点：（1）持续优化产品和客户结构，夯实消费电子领域基本盘，深耕汽车电子领域。公司在高端消费电子光电显示产品及触控笔记本产品端和研发技术持续发力，且公司前期开发的汽车电子领域头部客户陆续进入产量的爬坡阶段和大量产阶段，在主营业务收入结构中，汽车电子领域的产品销售占比从 2022 年的 21.27%上升到报告期内的 30.65%。（2）坚持研发创新，注重科技成果转化；（3）股权激励的积极影响，驱动公司核心人员努力拼搏；（4）坚持高效管理，内控规范及降本增效。

8.公司将启动海外工厂的布局，这是否意味着公司将面临更多的国际竞争和市场风险？公司将如何应对这些挑战？

答:投资者您好，公司启动海外工厂的布局主要系基于现有客户的海外配套需求，总体风险相对可控，但由于泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，泰国公司在设立及建设过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性，基于谨慎性原则，公司将采用初期小规模投入，后期再根据具体情况决定是否扩大投资的策略，以应对市场竞争风险，此外，公司将积极学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验，尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系，采取有效的措施激励和培训团队，保障泰国公司的良好运行。

9.公司在研发投入方面有哪些新的计划或项目，特别是在新能源汽车和消费电子领域的研发方向是什么？

答:投资者您好，汽车电子领域和高端消费电子领域一直公司战略规划的重点领域。未来，公司将稳步提升汽车电子 PCB 产能，并持续加大对新能源车核心三电（电池、电机、电控）系统、自动驾驶系统、安全系统等 PCB 产品的研发投入。同时，为了满足客户个性化、多样化和高阶化的产品结构需求，公司引进了行业多位高阶 PCB 和

	<p>HDI 的专业人才，在巩固刚性板产品优势的基础上，组织开展对高阶 PCB 和密度互联板（HDI）等的研发拓展工作。再次，进一步深入加强对高频/高速板、超厚铜板、陶瓷基板、埋铜块等特殊产品的工艺研发，不断丰富完善公司产品结构，提升公司整体竞争力。2024 年，研发团队将积极深入销售团队，前瞻性的参与客户产品的技术探讨，为实现研发成果转化的高效性和精准性奠定基础。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 5 月 10 日